

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit













OMNIMATE[®] - Connecteurs carte-à-carte

Ingénierie flexible des appareils compacts
L'utilisation de systèmes de contact à l'épreuve du temps, ainsi que l'optimisation des processus de fabrication, sont de plus en plus importantes dans le développement de dispositifs industriels efficaces, en particulier dans le domaine de l'industrie 4.0. Les connecteurs carte-à-carte
OMNIMATE[®] ont un pas de 1,27 mm et offrent une flexibilité maximale grâce à des conceptions variées.

- Conception de dispositifs flexibles Densité adaptée à l'industrie combinée à des combinaisons de connexions très flexibles (Mezzanine, Mère-fille, Carte d'extension, Câble-à-carte)
- **Prêt pour l'automatisation** Développé pour l'assemblage automatique avec une coplanarité des broches de haute précision et une fixation SMT
- **Un contact fiable** Jusqu'à 500 cycles d'accouplement grâce à une surface en or adaptée à l'industrie (PdNi-Au)
- **Prêt pour le processus** Matériau LCP à haute performance pour le soudage par refusion
- Évolutivité Des hauteurs différentes avec un fort chevauchement des contacts assurent des solutions variées de 12 à 80 pôles.
- **Une miniaturisation robuste** connexion simple et sûre même possible dans des conditions d'accouplement défavorables par exemple, inclinaison ou décalage.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur fe- melle, Raccordement soudé SMD, Pas en mm (P):
	1.27 mm, Nombre de pôles: 40, 180°, Tape
Référence	<u>2747390000</u>
Туре	FFH9 S1/40V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000761
Qté.	280 pièce(s)
Indices de produit	IEC: / 2.8 A
	UL: 150 V
Emballage	Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	7,8 mm	Profondeur (pouces)	0,307 inch
Hauteur	9,9 mm	Hauteur (pouces)	0,39 inch
Largeur	30,48 mm	Largeur (pouces)	1,2 inch
Poids net	6,257 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Caractéristiques du système

Vitesse de transmission		Famille de produits	OMNIMATE Signal - Carte-
	3.125 Gbit/s		à-Carte
Type de raccordement	Raccordement sur platine	Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD
Pas en mm (P)	1,27 mm	Pas en pouces (P)	0,05 "
Angle de sortie	180°	Nombre de pôles	40
Nombre de picots par pôle	1	Coplanarité :	0,1 mm
Nombre de séries	1	Nombre de pôles	2
Degré de protection	IP20	Résistance de passage	<25 mΩ
Cycles d'enfichage	500	Force d'enfichage/pôle, max.	0,6 N
Force d'extraction/pôle, max.	0,6 N		

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	Illa
Tenue d'isolation	≥ 10 ¹⁰ Ω	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du contact	Alliage de cuivre
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm Pd-	Température de stockage, min.	
	Ni / ≥ 0.05 µm Au		-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-55 ℃
Température de fonctionnement , max.	125 °C		

Données nominales selon CEI

Courant nominal, nombre de pôles min.		Espace libre, min.	
(Tu = 20 °C)	2,8 A	•	0,4 mm
Ligne de fuite min	0.4 mm		

Données nominales selon UL 1977

Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications in- diquent les valeurs maxi- males. Détails - voir le certi-	Tension nominale (UL 1977) (obsolète)	
	ficat d'agrément.		150 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	350 mm
Largeur VPE	345 mm	Hauteur VPE	135 mm

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils
	sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives
	selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Agréments

Agréments	
	C TOTAL IIC
	C # 100 U3

Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cl.IRus)	F92202

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	Technische Änderung für Board-to-Board Steckverbinder - Lötstiftlänge und PPP Technical change to Board-to-Board connectors - solder pin length and PPP
Catalogue	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

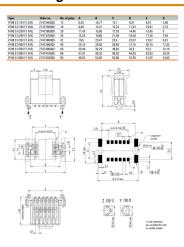
www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit

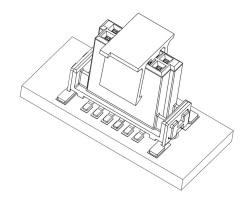


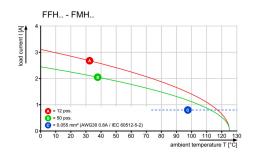
Dimensional drawing



Dessin détaillé

Courbe de dérating







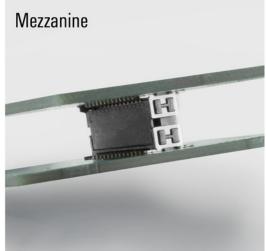
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

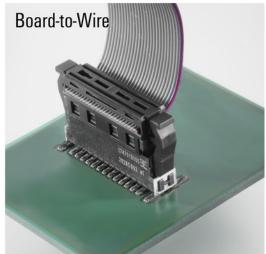
www.weidmueller.com

Dessins



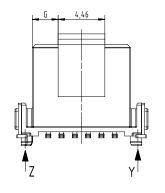


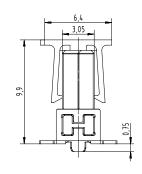




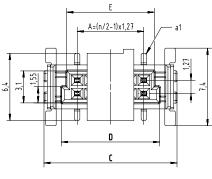


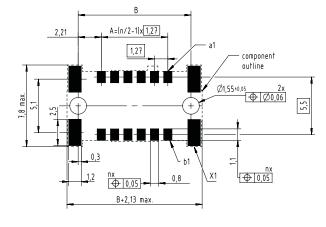
FFH9 S1/..V F1 B RL

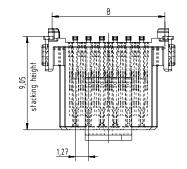


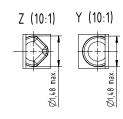


Туре	Order no.	No. of poles	Α	В	С	D	E	G
FFH9 S1/12V F1 B RL	2747340000	12	6,35	10,77	12,7	9,37	8,37	2,46
FFH9 S1/16V F1 B RL	2747350000	16	8,89	13,31	15,24	11,91	10,91	3,73
FFH9 S1/20V F1 B RL	2747360000	20	11,43	15,85	17,78	14,45	13,45	5
FFH9 S1/26V F1 B RL	2747370000	26	15,24	19,66	21,59	18,26	17,26	7,54
FFH9 S1/32V F1 B RL	2747380000	32	19,5	23,47	25,4	22,07	21,07	8,81
FFH9 S1/40V F1 B RL	2747390000	40	24,13	28,55	30,48	27,15	26,15	11,35
FFH9 S1/50V F1 B RL	2747400000	50	30,48	34,29	36,83	33,5	32,5	15,16
FFH9 S1/68V F1 B RL	2747410000	68	41,91	46,33	48,26	44,93	43,93	20,24
FFH9 S1/80V F1 B RL	2747420000	80	49,53	53,95	55,88	52,55	51,55	24,05

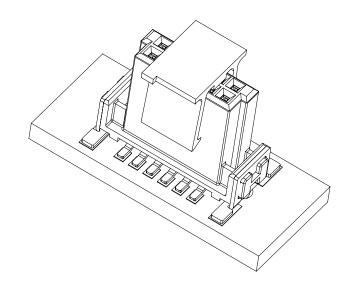








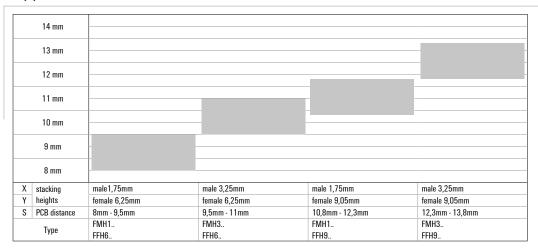
x= only mechanical np= not plated thru hole n= number of poles

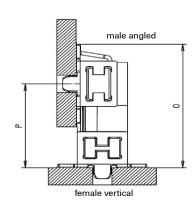




Female vertical - FFH6 | FFH9

Application - dimensions



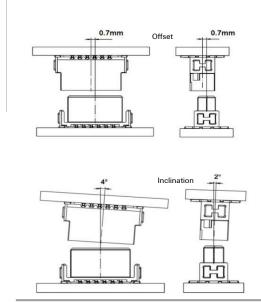


*S max. = S min. + 1,15 wiping length with additional contact overlap security

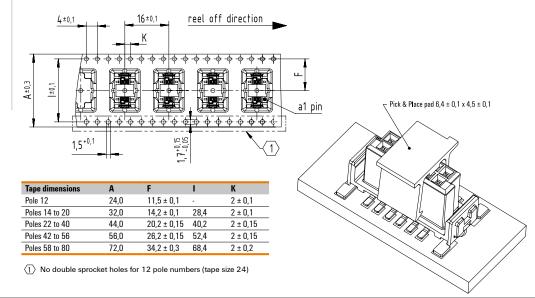
female vertical

Υ	S min.	*S max.	P min.	0
9,05	12,3	13,8	-	-
9,05	10,8	12,3	-	-
6,25	9,5	11	-	-
6,25	8	9,5	-	-
9,05	-	-	10,5	14,33
6,25	-	-	7,7	11,53
	9,05 9,05 6,25 6,25 9,05	9,05 12,3 9,05 10,8 6,25 9,5 6,25 8 9,05 -	9,05 12,3 13,8 9,05 10,8 12,3 6,25 9,5 11 6,25 8 9,5 9,05 -	9,05 12,3 13,8 - 9,05 10,8 12,3 - 6,25 9,5 11 - 6,25 8 9,5 - 9,05 - 10,5

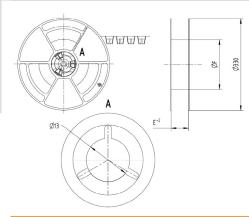
Mating conditions



Tape - dimensions



Reel - dimensions



E	F
24,4	
32,4	— 170mm for stocking beight
44,4	— 178mm for stacking height — 1.75mm & 3.25mm
56,4	— 1,75111111 & 3,25111111
72,4	
	32,4 44,4 56,4

We reserve the right to make technical changes.

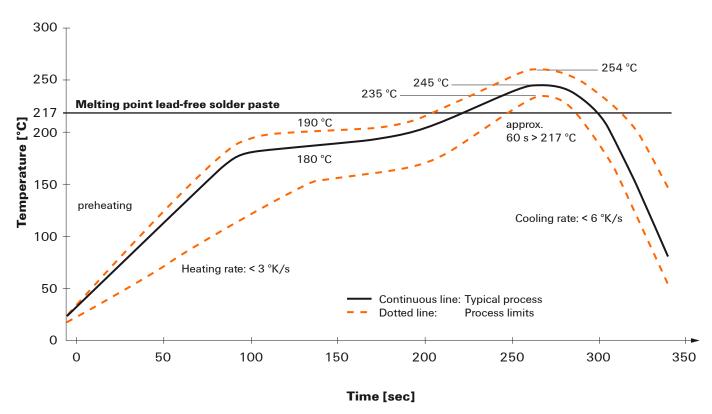


Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- · Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- · Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3$ K/s. In parallel the solder paste is ,activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at \geq -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.